

Kongresstag 1, 22. Mai 2019

09:30 Begrüßung und Übersicht zum Fachkongress
durch Alfred Vollmer, Chefredakteur elektronik journal,
und Hans Jaschinski, Chefredakteur elektronik industrie

Kommunikation und 5G

09:45 Mindsphere – Die Lösung für das Internet der Dinge
Lucia Wagner, Vice President of Germany Sales, Mindsphere at Siemens

10:15 Nicht auf 5G warten – Das IoT braucht kein Internet
Neil Hamilton, Vice President of Business Development, Thingstream

10:45 Pause, Networking und Besuch der Fachausstellung

11:15 Sigfox – Applikationen und zukünftige Entwicklungen
Aurelius Wosylus, Chief Sales Officer Germany, Sigfox

11:45 5G Alliance for Connected Industries und Automation (5G-ACIA) –
A global initiative lifting Industry 4.0 to the next level
Josef Eichinger, Board-Mitglied ZVEI 5G-ACIA
und Leiter des Wireless System Designs bei Huawei Technologies

12:15 Status und Zukunft der OPC UA-Technologie
Stefan Hoppe, Lead Product Manager, OPC Foundation

12:45 Mittagspause, Networking und Besuch der Fachmesse

Steuerung und Robotik

14:00 Weg mit dem schaltschrank und raus aus dem Käfig:
Steuerung und Safety dezentralisieren
Nikolai Ensslen, President & CEO, Synapticon

14:30 Hallo Kollege – Voraussetzungen für die
Zusammenarbeit von Mensch und Roboter
Dr. Clemens Müller, Director Business Development Robotics, Infineon

15:00 Fokus Robotik – aber wie?
TBA, Analog Devices

15:30 Pause, Networking und Besuch der Fachausstellung

Künstliche Intelligenz

16:00 Künstliche Intelligenz in der Robotik

Bruno Adam, Europa-Direktor für mobile Projekte, Omron

16:30 Spiking Neural Networks (Englisch)

Robert Beachler, SVP Marketing and Business Development, Brainchip

17:00 Convolutional Neural Networks and Tensilica-IP (Englisch)

Lazaar Louis, Marketing and Business Development Leader, Cadence (Englisch)

17:30 Zusammenfassung des ersten Kongresstages

Alfred Vollmer, Chefredakteur elektronik journal,
und Hans Jaschinski, Chefredakteur elektronik industrie

17:35 Ende des ersten Vortragstages

18:00 Beginn der Abendveranstaltung

Kongresstag 2, 23. Mai 2019

Obsoleszenz

09:00 Obsoleszenz – die Folgen steigender Innovation

Dr. Wolfgang Heinbach, Vorsitzender COG,
Component Obsolescence Group Deutschland e. V.

09:30 An Alternative to traditional Component Obsolescence (Englisch)

Ken Greenwood, Technical Sales Manager EMEA, Rochester Electronics

3D-Druck

10:00 Bedeutung von 3D-Druck om der Elektronikfertigung

Franz Plachy, Sales Manager, Ekra

10:30 Pause, Networking und Besuch der Fachausstellung

Security

11:00 Warum Security notwendig ist

Dr. Peter Laackmann, Senior Principal Digital Security Solutions,
und Marcus Janke, Senior Principal Product and System Security, Infineon

11:30 Cybersecurity in LXI-LAN-basierten Testsystemen

Jochen Wolle, Technical Consultant, LXI Consortium

Messtechnik

12:00 Automatisierte Testsysteme im Umfeld von Industrie 4.0

Christian Korreng, Leitung Vertrieb, und Klaus-Gunther Marschner,
Leitung Softwareentwicklung, LX Instruments

Automation und Human Machine Interfaces

12:30 HMI 5.0 Bedientechnologien der Zukunft
Rudolf Sosnowsky, CTO, Hy-Line Computer Components

13:00 Mittagspause, Networking und Besuch der Fachausstellung

Automation und Industrie 4.0

14:00 Big Data und virtuelle Realität
Hubert Egger, Director Product Line Factory Solutions, ASM Assembly Systems

14:30 Smart Factory mit Big Data managen
Thomas Mückl, Deputy Director Global Engineering, Zollner Elektronik

15:00 Industrielle Kommunikation 4.0
Sebastian Hilscher, Development Division Manager,
Hilscher Gesellschaft für Systemautomation

15:30 Kaffeepause, Networking und Besuch der Fachausstellung

15:45 Industrie 4.0 und linienübergreifende Software
Stephan Häfele, Senior Director Sales
and Business Development, Aegis Software

16:15 Predictive Maintenance in der Elektronikfertigung
TBA, Rehm Thermal Systems

16:45 Zusammenfassung und Abschied
Alfred Vollmer, Chefredakteur elektronik journal,
und Hans Jaschinski, Chefredakteur elektronik industrie

17:00 Ende der Veranstaltung